

HeBoFill® CL-SP 035

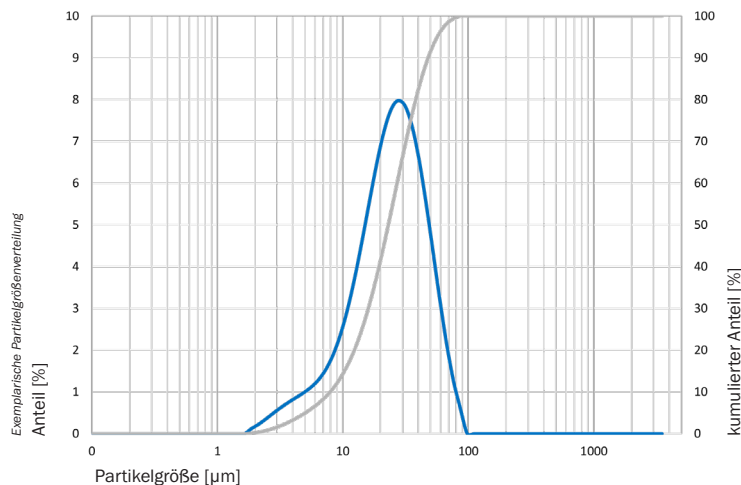
Cool Line - Single Platelet + D₅₀

HeBoFill® CL-SP 035 ist ein Bornitrid-Pulver mit grober Kornstruktur und hoher Reinheit. Die mittlere Teilchengröße liegt bei 35 µm. Durch die sehr niedrige spezifische Oberfläche sind hohe Füllgrade möglich ohne die Viskosität zu erhöhen. Es ist hervorragend geeignet als Füllstoff in Kunststoffen, da es die Wärmeleitfähigkeit erhöht und gleichzeitig die elektrische Isolierung beibehält.

- Vorteile**
- ▶ Sehr gute Wärmeleitfähigkeit - schon bei geringem Füllgrad
 - ▶ Elektrisch isolierend
 - ▶ Hohe Reinheit
 - ▶ Sehr geringe spezifische Oberfläche
 - ▶ Ermöglicht sehr hohe Füllgrade
 - ▶ Sehr große Einzelkristalle
 - ▶ Minimaler Werkzeugverschleiß im Vergleich zu anderen Füllstoffen
 - ▶ Physiologisch unbedenklich

- Typische Anwendungen**
- ▶ Füllstoff in Thermal Management Anwendungen
 - ▶ Füllstoff für Wärmeleitpasten und Vergussmassen
 - ▶ Füllstoff für Silikonharze, Thermoplaste und Duroplaste

- Typische Werte**
- ▶ Farbe: Weiß
 - ▶ Bornitrid: > 99,0 %
 - ▶ Gesamt Sauerstoff: < 0,5 %
 - ▶ Boroxid: < 0,1 %
 - ▶ Kohlenstoff: < 0,1 %
 - ▶ Spez. Oberfläche (BET): ~ 1 m²/g
 - ▶ Mittlere Teilchengröße (D₅₀): ~ 35 µm



- Verpackungseinheiten**
- ▶ 1 kg im Kunststoffbeutel
 - ▶ 10 kg im Hartpapierfass

Lagerung und Sicherheit Trocken lagern. Originalgebinde ab Lieferdatum mindestens 12 Monate haltbar. Weitere Angaben und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt.

Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkenndaten und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.

Henze Boron Nitride Products AG . Phone +49 8374.589 97-0 . info@henze-bnp.de . www.henze-bnp.de